

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-020

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月19日召开第五届董事会第二次会议、2024年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2025年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过37.8亿元人民币；其中，公司拟对子公司武汉精鸿电子技术有限公司（以下简称“武汉精鸿”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币9,000万元，拟对子公司武汉精立电子技术有限公司（以下简称“武汉精立”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币8亿元，拟对子公司武汉精毅通电子技术有限公司（以下简称“武汉精毅通”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币2.5亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

公司分别于2025年10月28日、2025年11月17日召开第五届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授

信额度提供担保的议案》，公司拟对子公司苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币 1 亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2025-129）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，具体担保进展情况披露如下：

二、担保进展情况

为满足子公司武汉精鸿、武汉精立及武汉精毅通日常经营发展需要，公司近日与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行”）分别签订编号为“公高保字第 ZHHT25000179230001 号”、“公高保字第 ZHHT26000204025001 号”、“公高保字第 ZHHT26000204074001 号”的《最高额保证合同》，约定公司为武汉精鸿、武汉精立及武汉精毅通向民生银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

为满足子公司苏州精材日常经营发展需要，公司近日与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）签订编号为“07501BY25000017”的《最高额保证合同》，约定公司为苏州精材向宁波银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

三、担保合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》（编号：公高保字第 ZHHT25000179230001 号）

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司武汉分行
- 2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
- 3、债务人：武汉精鸿电子有限公司
- 4、保证额度有效期自 2025 年 12 月 23 日起至 2026 年 12 月 22 日

5、保证最高本金限额为人民币：壹仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。

8、保证期间：保证期间为债务履行期限届满日起三年。

(二) 《最高额保证合同》(编号：公高保字第 ZHHT26000204025001 号)

1、债权人：中国民生银行股份有限公司武汉分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：武汉精立电子技术有限公司

4、保证额度有效期自 2026 年 2 月 11 日起至 2027 年 2 月 11 日

5、保证最高本金限额为人民币：贰亿元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。

8、保证期间：保证期间为债务履行期限届满日起三年。

(三) 《最高额保证合同》(编号：公高保字第 ZHHT26000204074001 号)

1、债权人：中国民生银行股份有限公司武汉分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：武汉精毅通电子技术有限公司

4、保证额度有效期自 2026 年 2 月 11 日起至 2027 年 2 月 11 日

5、保证最高本金限额为人民币：陆仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。

8、保证期间：保证期间为债务履行期限届满日起三年。

(四) 《最高额保证合同》(编号：07501BY25000017)

1、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：苏州精材半导体科技有限公司

4、保证额度有效期自2026年1月14日起至2029年1月14日

5、保证最高本金限额为人民币：壹仟万元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

8、保证期间：保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为96,436.22万元(不含子公司对公司的担保)，占公司截至2024年12月31日净资产的27.84%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年2月27日